

**DEKLARACJA MINISTERIALNA**

**o handlu produktami technologii informatycznej (ITA)**

podpisana w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości

W dniu 13 grudnia 1996 r. została podpisana w Singapurze Deklaracja Ministerialna w sprawie handlu towarami technologii informatycznej (ITA), w następującym brzmieniu:

*Przekład*

**DEKLARACJA MINISTERIALNA**

**w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej**

Singapur, 13 grudnia 1996 r.

Ministrowie,

reprezentujący następujących Członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz państwa i odrębne terytoria celne będące w procesie przystępowania do WTO, które zgodziły się w Singapurze na rozwój świa-

towego handlu produktami technologii informatycznej i które reprezentują znacznie powyżej 80 procent światowego handlu tymi produktami (strony):

Australia

Kanada

Wspólnoty Europejskie

Islandia

Indonezja

Japonia

Korea

Norwegia

Odrębne terytoria celne Tajwanu, Penghu, Kinmen  
Hongkong i Matsu

Singapur

Szwajcaria<sup>1</sup>

Stany Zjednoczone

biorąc pod uwagę kluczową rolę handlu produktami technologii informatycznej w rozwoju przemysłu przetwarzania danych i w dynamicznym rozwoju gospodarki światowej,

uznając cele podniesienia poziomu życia, rozwoju produkcji i handlu towarami,

pragnąc osiągnąć maksymalną swobodę w światowym handlu produktami technologii informatycznej,

pragnąc zachęcić do dalszego rozwoju technicznego przemysłu technologii informatycznej na całym świecie,

pamiętając o pozytywnym wkładzie, jakiego technologia informatyczna dokonuje do globalnego rozwoju gospodarki i dobrobytu,

uzgodniwszy wprowadzenie w życie wyników niniejszych negocjacji przewidujących dodatkowe koncesje w porównaniu do list koncesyjnych załączonych do Protokołu z Marakeszu do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 i

uznając, że rezultaty przeprowadzonych negocjacji zawierają również pewne koncesje oferowane już w negocjacjach, które doprowadziły do ustanowienia list koncesyjnych załączonych do Protokołu z Marakeszu,

deklarują, co następuje:

1. System handlowy każdej ze stron będzie ewoluował w sposób ułatwiający dostęp do rynku dla produktów technologii informatycznej.
2. Zgodnie ze sposobami wywiązywania się z zobowiązań wymienionymi w załączniku do niniejszej deklaracji, każda ze stron zwiąże i wyeliminuje cła,

opłaty celne i inne opłaty jakiegokolwiek rodzaju w rozumieniu artykułu II:1(B) Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 w odniesieniu do:

(a) wszystkich produktów sklasyfikowanych lub które mogą być objęte klasyfikacją Zharmonizowanego Systemu (HS) 1996 w grupach wymienionych w Aneksie A do załącznika do niniejszej deklaracji; i

(b) wszystkich produktów wymienionych w Aneksie B do załącznika do niniejszej deklaracji niezależnie od tego, czy są wymienione w Aneksie A, czy nie;

poprzez redukcję w równych ratach stawek celnych, poczynając od 1997 r., a kończąc w roku 2000, uznając, że przedłużenie okresu redukcji i rozszerzenie objętej nią listy produktów przed wprowadzeniem jej w życie może być w ograniczonych okolicznościach konieczne.

3. Ministrowie wyrażają zadowolenie, że tak obszerna lista towarów została ujęta w aneksach do załącznika do niniejszej deklaracji. Polecają oni reprezentującym ich urzędnikom, aby podjęli wysiłki w dobrej wierze, by sfinalizować techniczne dyskusje wielostronne w Genewie w oparciu o sposoby wywiązywania się z zobowiązań, i poinformują tych urzędników, aby zakończyli prace do 31 stycznia 1997 r., tak aby zapewnić wprowadzenie w życie niniejszej deklaracji przez jak największą liczbę uczestników.
4. Ministrowie zwracają się do ministrów innych Członków WTO i państw oraz odrębnych terytoriów celnych w procesie przystępowania do WTO, aby wydali odpowiednie instrukcje swoim właściwym urzędnikom, żeby mogli uczestniczyć w dyskusjach technicznych wspomnianych w ustępie 3 powyżej i w pełni uczestniczyli w rozwoju światowego handlu produktami technologii informatycznej.

Załącznik: Sposoby wywiązywania się z zobowiązań  
Aneks A: Lista grup HS  
Aneks B: Lista produktów

ZAŁĄCZNIK

## SPOSOBY WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ I LISTY TOWAROWE

Jakikolwiek Członek Światowej Organizacji Handlu albo państwo lub odrębne terytorium celne w procesie przystąpienia do WTO mogą uczestniczyć w procesie rozwoju handlu światowego produktami technologii informatycznej zgodnie z następującymi sposobami wywiązywania się z zobowiązań:

1. Każdy uczestnik wprowadzi środki opisane w ustępie 2 Deklaracji do swojej listy koncesyjnej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 i dodatkowo do każdej linii taryfowej w systemie HS 1996 na poziomie sześciocyfrowym w swojej oficjalnej taryfie celnej czy jakiegokolwiek innej publikowa-

<sup>1</sup> W imieniu unii celnej Szwajcarii i Liechtensteinu.

nej wersji taryfy celnej, którakolwiek z nich jest zazwyczaj stosowana przez importerów i eksporterów. Każdy uczestnik, który nie jest Członkiem WTO, wprowadzi te środki autonomicznie po zakończeniu procesu przystępowania do WTO i włączy te środki do swoich towarowych list koncesyjnych WTO dostępu do rynku.

2. W tym celu, tak wcześnie, jak to tylko możliwe, ale nie później niż 1 marca 1997 r., każdy uczestnik przedstawi innym uczestnikom dokument zawierający (a) szczegóły podające, jak odpowiednio traktowanie celne będzie odzwierciedlone w jego liście koncesyjnej WTO i (b) szczegółową listę HS dotyczącą produktów wymienionych w Aneksie B. Dokumenty te będą przejrzane i zaaprobowane w drodze consensusu, a proces ich przeglądu będzie zakończony nie później niż do 1 kwietnia 1997 r. Jak tylko proces przeglądu zostanie zakończony dla każdego takiego dokumentu, dokument ten zostanie przekazany w celu dokonania modyfikacji listy koncesyjnej zainteresowanego uczestnika zgodnie z decyzją z dnia 26 marca 1980 r. w sprawie procedur dotyczących modyfikacji i zmian list koncesyjnych (BISD 27S/25).

(a) Koncesje, które mają być zaoferowane przez każdego uczestnika jako modyfikacje jego listy koncesyjnej, obejmą związanie i eliminację stawek celnych i wszelkich innych opłat jakiegokolwiek rodzaju na produkty technologii informatycznej, jak następuje:

(i) eliminacja takich stawek celnych odbędzie się w równych ratach, chyba że uczestnicy uzgodnią inaczej. Jeśli uczestnicy nie uzgodnią inaczej, każdy uczestnik zwiąże stawki celne na pozycje wymienione w aneksach nie później niż do 1 lipca 1997 r. oraz dokona pierwszej obniżki stawek nie później niż do 1 lipca 1997 r. Druga obniżka stawek celnych nastąpi nie później niż do 1 stycznia 1998 r., trzecia obniżka nie później niż do 1 stycznia 1999 r., a eliminacja stawek celnych będzie zakończona nie później niż do 1 stycznia 2000 r. Uczestnicy zgadzają się zachęcać do autonomicznej eliminacji stawek celnych przed wskazanymi datami. Obniżona stawka celna na każdym etapie będzie zaokrąglona do jednej cyfry po przecinku.

(ii) eliminacja jakichkolwiek innych opłat w rozumieniu artykułu II:1(b) Układu ogólnego będzie zakończona do 1 lipca 1997 r., chyba że będzie wskazane inaczej w dokumencie przedstawionym przez uczestnika do przeglądu innym uczestnikom.

(b) Modyfikacje list koncesyjnych zaproponowane przez uczestnika w celu wprowadzenia w życie wiązań i eliminacji stawek celnych na produkty technologii informatycznej doprowadzą do następującego rezultatu:

(i) w przypadku pozycji HS wymienionych w Aneksie A przez stworzenie, gdzie to właściwe, podpozycji w liście koncesyjnej i w taryfie celnej; i

(ii) w przypadku produktów wymienionych w Aneksie B przez dołączenie do listy koncesyjnej aneksu zawierającego wszystkie produkty wymienione w Aneksie B, w którym podane bę-

dą szczegółowe pozycje HS dla tych produktów albo odpowiadające pozycjom w taryfie celnej, albo na sześciocyfrowym poziomie HS.

Każdy uczestnik pilnie zmodyfikuje swoją taryfę celną w celu odzwierciedlenia proponowanych modyfikacji, jak tylko wejdą w życie.

3. Uczestnicy będą spotykać się okresowo pod auspicjami Rady Handlu Towarami w celu dokonania przeglądu objęcia koncesjami produktów wymienionych w aneksach, w celu uzgodnienia w drodze consensusu, czy w świetle postępu technologicznego, doświadczeń we wprowadzaniu koncesji taryfowych lub zmian w nomenklaturze HS, aneksy będą modyfikowane w celu objęcia nimi dodatkowych produktów, oraz by konsultować się w sprawach barier pozataryfowych w handlu produktami technologii informatycznej. Konsultacje takie nie naruszają praw i obowiązków w ramach Porozumienia WTO.

4. Uczestnicy spotkają się tak szybko, jak to będzie celowe, a w każdym razie nie później niż 1 kwietnia 1997 r., aby dokonać przeglądu stanu otrzymanych akceptacji i ocenić wnioski, jakie można z nich wyciągnąć. Uczestnicy podejmą działania przewidziane w Deklaracji pod warunkiem, że uczestnicy reprezentujący około 90 procent handlu światowego<sup>2</sup> produktami technologii informatycznej notyfikowali swoją akceptację, i pod warunkiem, że etapy eliminacji zostały uzgodnione w sposób satysfakcjonujący uczestników. Przy ocenianiu, czy podjąć działania wymienione w Deklaracji, jeżeli procent handlu światowego reprezentowany przez uczestników będzie kształtował się nieco poniżej 90 procent światowego handlu produktami technologii informatycznej, uczestnicy mogą brać pod uwagę zakres uczestnictwa państw i odrębnych terytoriów celnych reprezentujących poważną część własnego handlu tymi produktami. Na spotkaniu tym uczestnicy ustalą, czy kryteria te zostały spełnione.

5. Uczestnicy będą spotykać się tak często, jak to będzie konieczne, ale nie później niż 30 września 1997 r., w celu przeanalizowania rozbieżności pomiędzy nimi w sprawie klasyfikacji produktów technologii informatycznej, poczynając od produktów wymienionych w Aneksie B. Uczestnicy zgadzają się co do wspólnego celu osiągnięcia, gdzie to będzie właściwe, wspólnej klasyfikacji tych produktów w ramach istniejącej nomenklatury HS, biorąc pod uwagę interpretacje i decyzje Rady Współpracy Celnej (zwanej też Światową Organizacją Celną lub WCO). W każdym przypadku utrzymywania się rozbieżności w klasyfikacji uczestnicy rozważą, czy mają wspólnie wystąpić do WCO z propozycją uaktualnienia istniejącej nomenklatury HS lub rozstrzygnięcia rozbieżności w interpretacji nomenklatury HS.

6. Uczestnicy rozumieją, że artykuł XXIII Układu ogólnego dotyczy anulowania lub naruszenia korzyści wynikających bezpośrednio lub pośrednio dla Członka

<sup>2</sup> Procent ten zostanie skalkulowany przez Sekretariat WTO na podstawie najświeższych dostępnych danych w czasie spotkania.

WTO w wyniku wprowadzenia w życie niniejszej Deklaracji w rezultacie zastosowania przez innego Członka WTO i uczestnika jakiegokolwiek środka, niezależnie od tego, czy jest on sprzeczny, czy nie z postanowieniami Układu ogólnego.

7. Każdy z uczestników przychylnie rozpatrzy jakiegokolwiek wniosek o konsultacje jakiegokolwiek innego uczestnika w sprawie wyżej ustalonych przedsięwzięć. Konsultacje takie nie będą naruszać praw i obowiązków wynikających z Porozumienia WTO.

8. Uczestnicy działający pod auspicjami Rady Handlu Towarami będą informować innych Członków WTO i inne państwa lub odrębne terytoria celne w procesie przystępowania do WTO o sposobach wywiązywania się z zobowiązań i rozpoczną konsultacje w celu ułatwienia ich udziału w rozwoju handlu produktami technologii informatycznej w oparciu o niniejszą Deklarację.

9. Wyraz „uczestnik” użyty przy omawianiu sposobów wywiązywania się z zobowiązań oznacza tych Członków WTO, państwa lub odrębne terytoria celne w procesie przystępowania do WTO, które złożą dokument opisany w ustępie 2 nie później niż do 1 marca 1997 r.

10. Niniejszy załącznik jest otwarty do akceptacji przez wszystkich Członków WTO oraz państwa i odrębne terytoria celne w procesie przystępowania do WTO. Akceptacje będą notyfikowane pisemnie Dyrektorowi Generalnemu, który powiadomi o nich uczestników.

Do niniejszego załącznika dołączone są dwa aneksy.

Aneks A zawiera objęte pozycje HS lub ich części.

Aneks B zawiera konkretne produkty, które mają być objęte Porozumieniem, jeżeli są sklasyfikowane w systemie HS.

**Aneks A**

## Sekcja 1

HS96		Opis	
	<b>3818</b>		Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice w postaci krążków, płytek i form podobnych; związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
	8469	11	Maszyny do redagowania tekstów
	<b>8470</b>		<b>Maszyny liczące i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych; maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny wyposażone w urządzenia liczące; kasy rejestrujące</b>
	8470	10	Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła zasilania i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych
	8470	21	Inne elektroniczne maszyny kalkulacyjne wyposażone w drukarkę
	8470	29	Pozostałe
	8470	30	Pozostałe maszyny liczące
	8470	40	Maszyny do księgowania
	8470	50	Kasy rejestrujące
	8470	90	Pozostałe
	<b>8471</b>		<b>Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do tych maszyn; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych niewymienione ani nieujęte gdzie indziej</b>

	8471	10	Maszyny analogowe lub hybrydowe do automatycznego przetwarzania danych
	8471	30	Przenośne maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych o masie nie większej niż 10 kg, składające się co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitora
	8471	41	Inne maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia połączone lub nie
	8471	49	Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych przedstawione w formie systemów
	8471	50	Procesory cyfrowe inne niż objęte podpozycjami 8471 41 i 8671 49 zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejściowe, urządzenia wyjściowe
	8471	60	Urządzenia wejściowe i wyjściowe, nawet zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci
	8471	70	Urządzenia pamięci, w tym urządzenia pamięci centralnej, urządzenia pamięci dyskowej, w tym optyczne, urządzenia magnetycznej pamięci taśmowej
	8471	80	Pozostałe urządzenia do maszyn automatycznego przetwarzania danych
	8471	90	Pozostałe
ex	8472	90	Automatyczne maszyny do liczenia banknotów i monet
	8473	21	Części i akcesoria do maszyn z pozycji 8470 do kalkulatorów elektronicznych z podpozycji 8470 10, 8470 21 i 8470 29
	8473	29	Części i akcesoria do maszyn z pozycji 8470 do kalkulatorów elektronicznych innych niż w podpozycjach 8470 10, 8470 21 i 8470 29
	8473	30	Części i akcesoria do maszyn z pozycji 8471
	8473	50	Części i akcesoria w równym stopniu odpowiednie do użycia w maszynach i urządzeniach klasyfikowanych w dwóch lub więcej pozycjach od nr 8469 do 8472
ex	8504	40	Przekształtniki statyczne stosowane z maszynami do automatycznego przetwarzania danych i ich podzespołami i urządzeniami telekomunikacyjnymi
ex	8504	50	Inne wzбудniki stosowane z maszynami do automatycznego przetwarzania danych i ich podzespołami i urządzeniami telekomunikacyjnymi

	8517		Elektryczny sprzęt do telefonii i telegrafii przewodowej, włączając przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową, oraz sprzęt telekomunikacyjny dla systemów przewodowych na prąd nośny lub dla systemów przewodowych cyfrowych; wideofony
	8517	11	Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
	8517	19	Pozostałe aparaty telefoniczne i wideofony
	8517	21	Telefaxy
	8517	22	Dalekopisy
	8517	30	Urządzenia łączeniowe dla telefonii i telegrafii
	8517	50	Inna aparatura dla systemów przewodowych na prąd nośny lub dla systemów przewodowych cyfrowych
	8517	80	Pozostała aparatura dla systemów z hasłowym przywołaniem
	8517	90	Części do aparatów z pozycji 8517
ex	8518	10	Mikrofony o częstotliwości 300 Hz do 3,4 kHz o średnicy nieprzekraczającej 10 mm i wysokości nieprzekraczającej 3 mm dla urządzeń telekomunikacyjnych
ex	8518	30	Słuchawki do telefonów przewodowych
ex	8518	29	Głośniki bez obudowy o częstotliwości 300 Hz do 3,4 kHz o średnicy nieprzekraczającej 50 mm dla urządzeń telekomunikacyjnych
	8520	20	Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjne
	8523	11	Taśmy magnetyczne o szerokości nieprzekraczającej 4 mm
	8523	12	Taśmy magnetyczne o szerokości powyżej 4 mm, ale nieprzekraczającej 6,5 mm
	8523	13	Taśmy magnetyczne o szerokości powyżej 6,5 mm
	8523	20	Dyski magnetyczne
	8523	90	Pozostałe
	8524	31	Dyski do systemów odczytu laserowego do odtwarzania zjawisk fizycznych innych niż dźwięk lub obraz
ex	8524	39	Pozostałe - do odtwarzania zapisów instrukcji, danych, dźwięku i obrazu zapisanych maszynowo i możliwych do odczytania w formie binamej oraz możliwe do posługiwania się przez użytkownika poprzez maszyny do automatycznego przetwarzania danych

	8524	40	Taśmy magnetyczne do odtwarzania zjawisk fizycznych innych niż dźwięk lub obraz
	8524	91	Pozostałe środki do odtwarzania zjawisk fizycznych innych niż dźwięk lub obraz
ex	8524	99	Pozostałe - do odtwarzania zapisów instrukcji, danych, dźwięku i obrazu zapisanych maszynowo i możliwych do odczytania w formie binarnej oraz możliwe do posługiwania się przez użytkownika poprzez maszyny do automatycznego przetwarzania danych
ex	8525	10	Urządzenia nadawcze inne niż urządzenia dla radiofonii i telewizji
	8525	20	Urządzenia nadawcze zawierające aparaturę odbiorczą
ex	8525	40	Cyfrowe kamery video ze stop-klatką
ex	8527	90	Odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych
ex	8529	10	Anteny rodzaju używanego z aparaturą dla radiotelefonii i radiotelegrafii
ex	8529	90	Części -do aparatury nadawczej innej niż radiowa i telewizyjna, zawierającej aparaturę odbiorczą, cyfrowych kamer video ze stop-klatką i odbiorników przenośnych dla systemów przywoławczych
	8531	20	Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) lub diody elektroluminescencyjne (LED)
ex	8531	90	Części do aparatury z podpozycji 8531 20
	<b>8532</b>		<b>Kondensatory elektryczne stałe, nastawne lub strojeniowe</b>
	8532	10	Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań w obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej nie mniejszej niż 0,5 kvar (kondensatory mocy)
	8532	21	Tantalowe
	8532	22	Elektrolityczne aluminiowe
	8532	23	Ceramiczne jednowarstwowe
	8532	24	Ceramiczne wielowarstwowe
	8532	25	Z dielektrykiem na bazie papieru lub tworzywa sztucznego



	8532	29	Pozostałe
	8532	30	Kondensatory nastawne lub strojeniowe
	9532	90	Części
	<b>8533</b>		<b>Rezystory (w tym reostaty i potencjometry) niebędące rezystorami grzejnymi</b>
	8533	10	Rezystory stałe węglowe, masowe lub warstwowe
	8533	21	Inne rezystory stałe dla mocy nieprzekraczającej 20 W
	8533	29	Pozostałe rezystory stałe dla mocy 20 W lub więcej
	8533	31	Rezystory drutowe zmienne, w tym reostaty i potencjometry dla mocy nieprzekraczającej 20 W
	8533	39	Rezystory drutowe zmienne, w tym reostaty i potencjometry dla mocy 20 W lub więcej
	8533	40	Pozostałe rezystory nastawne, w tym rezystory regulowane (reostaty i potencjometry)
	8533	90	Części
	<b>8534</b>		<b>Obwody drukowane</b>
ex	8536	50	Elektroniczne przełączniki prądu zmiennego z optycznie połączonymi obwodami wyjścia i wejścia (izolowane tyrystorowe przełączniki prądu zmiennego)
ex	8536	50	Elektroniczne przełączniki, w tym przełączniki chronione przed temperaturą, składające się z tranzystorów i logicznych obwodów scalonych dla napięć nieprzekraczających 1000 V
ex	8536	50	Elektromechaniczne wyłączniki dla prądów nieprzekraczających 11 A
ex	8536	69	Wtyki i gniazda wtykowe do przewodów koncentrycznych i do obwodów drukowanych
ex	8536	90	Elementy połączeniowe i złącza dla przewodów i kabli
	<b>8541</b>		<b>Diody, tranzystory i inne podobne urządzenia półprzewodnikowe, światłoczułe urządzenia półprzewodnikowe, w tym fotoogniwa, także zmontowane w moduły lub tworzące panele, diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne w oprawkach</b>
	8541	10	Diody oprócz fotodiod i diod elektroluminescencyjnych
	8541	21	Tranzystory inne niż tranzystory światłoczułe o mocy dopuszczalnej poniżej 1 W

	8541	29	Tranzystory inne niż tranzystory światłoczułe o mocy dopuszczalnej 1 W lub więcej
	8541	30	Tyrystory, diaki i triaki oprócz światłoczułych
	8541	40	Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, w tym fotoogniwa, także zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody świecące (elektroluminescencyjne)
	8541	50	Pozostałe elementy półprzewodnikowe
	8541	60	Oprawione kryształy piezoelektryczne
	8541	90	Części
	<b>8542</b>		<b>Elektroniczne układy scalone i mikromoduły</b>
	8542	12	Karty zawierające elektroniczne układy scalone (karty "inteligentne")
	8542	13	Półprzewodniki z warstwą tlenku metalu (technologia MOS)
	8542	14	Układy scalone otrzymywane w technologii dwubiegunowej
	8542	19	Pozostałe łącznie z elementami scalonymi otrzymywanymi w technologii mieszanej dwubiegunowej i MOS (technologia BIMOS)
	8542	30	Pozostałe układy scalone monolityczne
	8542	40	Układy scalone hybrydowe
	8542	50	Mikromoduły elektroniczne
	8542	90	Części
	8543	81	Karty i etykiety (identyfikatory zbliżeniowe)
ex	8543	89	Maszyny elektryczne z funkcjami tłumaczeniowymi lub słownikowymi
ex	8544	41	Inne przewody elektryczne dla napięć nieprzekraczających 80 V, zaopatrzone w końcówki w rodzaju stosowanych w telekomunikacji
ex	8544	49	Inne przewody elektryczne dla napięć nieprzekraczających 80 V, niezaopatrzone w końcówki w rodzaju stosowanych w telekomunikacji
ex	8544	51	Inne przewody elektryczne dla napięć przekraczających 80 V, ale nieprzekraczających 1000 V, zaopatrzone w końcówki w rodzaju stosowanych w telekomunikacji

	8544	70	Kable światłowodowe
	9009	11	Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszące obraz oryginału bezpośrednio na kopię (w procesie bezpośrednim)
	9009	21	Inne fotokopiarki z układem optycznym
	9009	90	Części i akcesoria
	<b>9026</b>		<b>Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej, z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032</b>
	9026	10	Instrumenty do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy
	9026	20	Instrumenty i aparatura do pomiaru lub kontroli ciśnienia
	9026	80	Pozostałe instrumenty i aparatura do pomiaru lub kontroli z pozycji nr 9026
	9026	90	Części i akcesoria do instrumentów i aparatury z pozycji nr 9026
	9027	20	Chromatografy i aparaty do elektroforezy
	9027	30	Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy stosowane w zakresie optycznym (promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)
	9027	50	Pozostałe przyrządy i aparaty stosowane w zakresie optycznym (promieniowanie ultrafioletowe, widzialne, podczerwone) z pozycji nr 9027
	9027	80	Pozostałe przyrządy i aparaty z pozycji nr 9027 (inne niż wymienione w podpozycji 9027 10
ex	9027	90	Części i akcesoria do produktów z pozycji nr 9027 innych niż do analizy gazu lub dymu i mikrotomów
	9030	40	Pozostałe przyrządy i aparaty przeznaczone specjalnie dla telekomunikacji (np. mierniki przesłuchu, mierniki wzmocnienia, mierniki współczynnika zniekształceń, poziomu szumów)

**Aneks A****Sekcja 2****Sprzęt do produkcji i testowania półprzewodników oraz jego części**

Kod HS		Opis	Uwagi
ex	7017 10	Kwarcowe probówki i pojemniki przeznaczone do umieszczania w piecach dyfuzyjnych i utleniających do produkcji płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8419 89	Aparatura do nakładania par chemicznych do produkcji półprzewodników	Do aneksu B
ex	8419 90	Części do aparatury do nakładania par chemicznych do produkcji półprzewodników	Do aneksu B
ex	8421 19	Suszarki wirówkowe do przetwarzania płytek półprzewodnikowych	
ex	8421 91	Części do suszarek wirówkowych do przetwarzania płytek półprzewodnikowych	
ex	8424 89	Maszyny czyszczące do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z przewodów metalowych pakietów półprzewodnikowych przed procesem powlekania galwanicznego	
ex	8424 89	Urządzenia rozpylające do wytrawiania, usuwania powłok lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	
ex	8424 90	Części do urządzeń rozpylających do wytrawiania, usuwania powłok lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	
ex	8456 10	Obrabiarki przeznaczone do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej lub fotonowej do produkcji płytek półprzewodnikowych	
ex	8456 91	Aparatura do usuwania powłok lub czyszczenia płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
	8456 91	Aparatura do suchego trawienia wzorów na materiałach półprzewodnikowych	

ex	8456 99	Frezarki działające na zasadzie ukierunkowanego strumienia jonów do wyrobu lub naprawy masek lub siatek do wzorów na urządzeniach półprzewodnikowych	
ex	8456 99	Laserowe urządzenia tnące do rozdzielania promieniem lasera stykających się ścieżek przy produkcji półprzewodników	Do aneksu B
ex	8464 10	Maszyny do cięcia półprzewodnikowych kryształów ciągnionych na płytki lub płytek półprzewodnikowych na "chipy"	Do aneksu B
ex	8464 20	Szlifierki lub polerki do obróbki płytek półprzewodnikowych	
ex	8464 90	Maszyny do trasowania lub zarysowywania płytek półprzewodnikowych	
ex	8466 91	Części do maszyn do cięcia półprzewodnikowych kryształów ciągnionych na płytki lub płytek półprzewodnikowych na "chipy"	Do aneksu B
ex	8466 91	Części do maszyn do trasowania lub zarysowywania płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8466 91	Części do szlifierek lub polerek do obróbki płytek półprzewodnikowych	
ex	8466 93	Części do frezarek działających na zasadzie ukierunkowanego strumienia jonów do wyrobu lub naprawy masek i siatek do wzorów na urządzeniach półprzewodnikowych	
ex	8466 93	Części do laserowych urządzeń tnących do rozdzielania promieniem lasera stykających się ścieżek przy produkcji półprzewodników	Do aneksu B
ex	8466 93	Części do obrabiarek przeznaczonych do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej lub fotonowej do produkcji płytek półprzewodnikowych	
ex	8466 93	Części do aparatury do usuwania powłok lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B

ex	8466 93	Części do maszyn do suchego trawienia wzorów na materiałach półprzewodnikowych	
ex	8477 10	Maszyny do montażu półprzewodników	Do aneksu B
ex	8477 90	Części do maszyn do montażu	Do aneksu B
ex	8479 50	Automatyczne maszyny do transportu, przemieszczania i składowania płytek półprzewodnikowych, kaset, pojemników i innych materiałów do urządzeń półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 89	Aparaty do hodowli lub wyciągania kryształów półprzewodnikowych	
ex	8479 89	Aparaty natryskowe do płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 89	Aparaty do mokrego wytrawiania, wywoływania, usuwania powłoki lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 89	Aparatura łączeniowa, wiążąca i drutowa do montażu półprzewodników	Do aneksu B
ex	8479 89	Aparatura zamykająca do montażu półprzewodników	Do aneksu B
ex	8479 89	Aparatura do osadzania warstwy epitaksjalnej na płytkach półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 89	Maszyny do zginania, zwijania i prostowania przewodów półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 89	Aparaty do nakładania warstwy na płytkach półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 89	Wirówki do nakładania emulsji fotograficznej na płytki półprzewodnikowe	Do aneksu B
ex	8479 90	Części do aparatury natryskowej do płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 90	Części do aparatury łączeniowej, wiążącej i drutowej do montażu półprzewodników	Do aneksu B
ex	8479 90	Części do wirówek do nakładania emulsji fotograficznej na płytki półprzewodnikowe	Do aneksu B

ex	8479 90	Części do aparatów do hodowli lub wyciągania kryształów półprzewodnikowych	
ex	8479 90	Części do aparatów do mokrego wytrawiania, wywoływania, usuwania powłoki lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 90	Części do automatycznych maszyn do transportu, przemieszczania i składowania płytek półprzewodnikowych, kaset, pojemników i innych materiałów do urządzeń półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 90	Części do aparatury zamykającej do motażu półprzewodników	Do aneksu B
ex	8479 90	Części do aparatów do osadzania warstwy epitaksjalnej na płytkach półprzewodnikowych	
ex	8479 90	Części do maszyn do zginania, zwijania i prostowania przewodów półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8479 90	Części do aparatury do nakładania warstwy na płytkach półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8480 71	Formy typu wtryskowego lub tłoczonego do produkcji urządzeń półprzewodnikowych	
ex	8514 10	Piece oporowe i suszarki do produkcji urządzeń półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych	
ex	8514 20	Piece i suszarki indukcyjne lub dielektryczne do produkcji urządzeń półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych	
ex	8514 30	Aparatura do szybkiego podgrzewania płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8514 30	Części do pieców oporowych i suszarek do produkcji urządzeń półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych	
ex	8514 90	Części do aparatury do szybkiego podgrzewania płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8514 90	Części do pieców i suszarek z podpozycji nr 8514 10 do nr 8514 30	

ex	8536 90	Waferprober	Do aneksu B
ex	8543 11	Jonowe aplikatory dla domieszkowania materiałów półprzewodnikowych	
ex	8543 30	Urządzenia do mokrego wytrawiania, wywoływania, usuwania powłoki lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8543 90	Części do urządzeń do mokrego wytrawiania, wywoływania, usuwania powłoki lub oczyszczania płytek półprzewodnikowych	Do aneksu B
ex	8543 90	Części do jonowych aplikatorów dla domieszkowania materiałów półprzewodnikowych	
	9010 41 do 9010 49	Urządzenia do rzutowania lub rysowania wzorów układów scalonych elektronicznych na materiałach światłoczułych	
ex	9010 90	Części i akcesoria do urządzeń z podpozycji nr 9010 41 do nr 9010 49	
ex	9011 10	Mikroskopy optyczne stereoskopowe wyposażone w specjalnie zaprojektowany sprzęt do obsługi i przekazywania płytek półprzewodnikowych i siatek	Do aneksu B
ex	9011 20	Fotomikrograficzne mikroskopy wyposażone w specjalnie zaprojektowany sprzęt do obsługi i przekazywania płytek półprzewodnikowych i siatek	Do aneksu B
ex	9011 90	Części i akcesoria do mikroskopów optycznych stereoskopowych wyposażonych w sprzęt specjalnie zaprojektowany do obsługi i przekazywania płytek półprzewodnikowych i siatek	Do aneksu B
ex	9011 90	Części i akcesoria do fotomikrograficznych mikroskopów wyposażonych w specjalnie zaprojektowany sprzęt do obsługi i przekazywania płytek półprzewodnikowych i siatek	Do aneksu B
ex	9012 10	Mikroskopy elektronowe wyposażone w sprzęt specjalnie zaprojektowany do obsługi i przekazywania płytek półprzewodnikowych i siatek	Do aneksu B



ex	9012 90	Części i akcesoria do mikroskopów elektronowych wyposażonych w sprzęt specjalnie zaprojektowany do obsługi i przekazywania płytek półprzewodnikowych i siatek	Do aneksu B
ex	9017 20	Aparaty wytwarzające wzór w rodzaju używanych do produkcji masek lub siatek z podłoży pokrytych warstwą fotolitograficzną	Do aneksu B
ex	9017 90	Części i akcesoria do aparatów wytwarzających wzór w rodzaju używanych do produkcji masek lub siatek z podłoży pokrytych warstwą fotolitograficzną	Do aneksu B
ex	9017 90	Części takich aparatów wytwarzających wzór	Do aneksu B
	9030 82	Przyrządy i aparaty kontrolno - pomiarowe do płytek i urządzeń półprzewodnikowych	
ex	9030 90	Części i akcesoria przyrządów i aparatów kontrolno - pomiarowych do płytek i urządzeń półprzewodnikowych	
ex	9030 90	Części przyrządów i wyposażenie kontrolno - pomiarowe do płytek i urządzeń półprzewodnikowych	
	9031 41	Przyrządy i aparaty optyczne do kontroli płytek i urządzeń półprzewodnikowych lub do kontroli masek, fotomasek i siatek używanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych	
ex	9031 49	Optyczne przyrządy i urządzenia do pomiaru powierzchniowego zanieczyszczenia cząstkami stałymi na płytkach półprzewodnikowych	
ex	9031 90	Części i akcesoria do optycznych przyrządów i urządzeń do kontroli płytek i urządzeń półprzewodnikowych lub do kontroli masek, fotomasek i siatek używanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych	

ex	9031 90	Części i akcesoria do optycznych przyrządów i urządzeń do pomiaru powierzchniowego zanieczyszczenia cząstkami stałymi na płytkach półprzewodnikowych	
----	---------	--	--

## Aneks B

Pozytywna lista produktów, które mają być objęte Porozumieniem, jeżeli są sklasyfikowane w systemie HS

Kiedy wymieniane są części, mają być one objęte odpowiednio zgodnie z komentarzem HS 2 (b) do sekcji XVI i rozdziału 90

**Komputery:** automatyczne urządzenia do przetwarzania danych mogące: (1) zapamiętać program lub programy przetwarzania i przynajmniej dane potrzebne bezpośrednio do przeprowadzenia programu; (2) być programowane zgodnie z potrzebami użytkownika; (3) wykonywać obliczenia arytmetyczne określone przez użytkownika; i (4) wykonać bez interwencji człowieka program przetwarzania, który wymaga zmian w przeprowadzaniu programu w wyniku logicznej decyzji w czasie przetwarzania.

Porozumienie obejmuje takie automatyczne urządzenia przetwarzania danych niezależnie od tego, czy są w stanie, czy nie odebrać i przetworzyć za pomocą jednostki centralnej sygnały telefoniczne, telewizyjne lub inne przetworzone analogowo lub cyfrowo sygnały audio albo video. Urządzenia wykonujące specyficzną funkcję inną niż przetwarzanie danych lub zawierające albo współpracujące z urządzeniem do automatycznego przetwarzania danych, a niewyszczególnione w aneksach A i B, nie są objęte niniejszym Porozumieniem.

**Wzmacniacze elektryczne,** jeżeli są stosowane jako wzmacniaki w telefonii sieciowej objętej niniejszym Porozumieniem oraz ich części

**Panele** (w tym LCD, elektroluminescencyjne, plazmowe i in.) stosowane do produktów objętych niniejszym Porozumieniem oraz ich części.

**Sprzęt sieciowy:** aparaty sieci lokalnej (LAN) i ogólnej (WAN), w tym urządzenia przeznaczone wyłącznie lub głównie do umożliwienia połączeń pomiędzy automatycznymi urządzeniami do przetwarzania danych oraz ich jednostkami w sieci przeznaczonej głównie do wykorzystania takich środków, jak jednostki centralne, urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia, w tym adaptery, gniazda, wzmacniaki, konwertory, koncentratory, mostki, wybieraki połączeń i obwody drukowane dla fizycznego połączenia z maszynami do automatycznego przetwarzania danych i ich częściami.

**Monitory:** monitory do maszyn do automatycznego przetwarzania danych z lampami katodowymi z punktem ekranowym nie mniejszym niż 0,4 mm niezdolne do odbioru i przetworzenia sygnałów telewizyjnych lub innych przetworzonych analogowo lub cyfrowo sygnałów audio lub video bez pomocy jednostki centralnej komputera, jak określono w niniejszym Porozumieniu.

Porozumienie zatem nie obejmuje telewizorów, w tym telewizorów wysokiej rozdzielczości<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Uczestnicy dokonają przeglądu opisu tego produktu w styczniu 1999 r. zgodnie z postanowieniami dotyczącymi konsultacji w ustępie 3 Deklaracji.

<p><b>Optyczne pamięci dyskowe</b> do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (CD i DVD) niezależnie od tego, czy mają urządzenia do zapisu oraz odczytu we własnej obudowie, czy nie</p>
<p><b>Urządzenia przywoławcze</b> i ich części</p>
<p><b>Plotery</b> jako urządzenia wejścia lub wyjścia z pozycji HS nr 8471 lub jako maszyny rysujące i kreślące z pozycji HS nr 9017</p>
<p><b>Obwody drukowane</b> dla produktów objętych Porozumieniem, w tym takie obwody do połączeń zewnętrznych, jak karty zgodne z normą PCMCIA. Takie obwody drukowane składają się z jednego lub więcej obwodów z pozycji 8534 z zamontowanymi jednym lub więcej elementami aktywnymi oraz z pasywnymi elementami lub bez. Pojęcie "elementy aktywne" oznacza diody, tranzystory i podobne urządzenia półprzewodnikowe niezależnie od tego, czy są światłoczułe, czy nie, z pozycji 8541 oraz obwody scalone i mikroelementy z pozycji 8542</p>
<p><b>Panele wyświetlające</b> używane z maszynami do automatycznego przetwarzania danych, które mogą wyświetlić cyfrową informację generowaną przez jednostkę centralną</p>
<p><b>Urządzenia pamięciowe</b> o zastrzeżonym formacie używane w maszynach do automatycznego przetwarzania danych posiadające lub nie wymienne nośniki magnetyczne, optyczne lub w innej technologii, w tym Bernoulli Box, Syquest lub Zipdrive</p>
<p><b>Multimedialne zestawy udoskonalające</b> do maszyn do automatycznego przetwarzania danych oraz ich pojedyncze części przeznaczone do sprzedaży detalicznej i składające się przynajmniej z głośnika i/lub mikrofonu oraz obwodu drukowanego umożliwiającego maszynom do automatycznego przetwarzania danych i ich jednostkom przetwarzanie sygnałów audio</p>
<p><b>Urządzenia o funkcji komunikacyjnej:</b> urządzenia mikroprocesorowe zawierające modem w celu uzyskania dostępu do Internetu i pełniące funkcję wymiany informacji</p>

**MINISTERIAL DECLARATION ON TRADE IN  
INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS**

SINGAPORE, 13 DECEMBER 1996

*Ministers,*

*Representing* the following Members of the World Trade Organization ("WTO"), and States or separate customs territories in the process of acceding to the WTO, which have agreed in Singapore on the expansion of world trade in information technology products and which account for well over 80 per cent of world trade in these products ("parties"):

Australia	Norway
Canada	Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu
European Communities	Singapore
Hong Kong	Switzerland <sup>1</sup>
Iceland	Turkey
Indonesia	United States
Japan	
Korea	

*Considering* the key role of trade in information technology products in the development of information industries and in the dynamic expansion of the world economy,

*Recognizing* the goals of raising standards of living and expanding the production of and trade in goods;

*Desiring* to achieve maximum freedom of world trade in information technology products;

*Desiring* to encourage the continued technological development of the information technology industry on a world-wide basis;

*Mindful* of the positive contribution information technology makes to global economic growth and welfare;

---

<sup>1</sup>On behalf of the customs union Switzerland and Liechtenstein.

*Having agreed* to put into effect the results of these negotiations which involve concessions additional to those included in the Schedules attached to the Marrakesh Protocol to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, and

*Recognizing* that the results of these negotiations also involve some concessions offered in negotiations leading to the establishment of Schedules annexed to the Marrakesh Protocol,

*Declare* as follows:

1. Each party's trade regime should evolve in a manner that enhances market access opportunities for information technology products.
2. Pursuant to the modalities set forth in the Annex to this Declaration, each party shall bind and eliminate customs duties and other duties and charges of any kind, within the meaning of Article II:1(b) of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, with respect to the following:
  - (a) all products classified (or classifiable) with Harmonized System (1996) ("HS") headings listed in Attachment A to the Annex to this Declaration; and
  - (b) all products specified in Attachment B to the Annex to this Declaration, whether or not they are included in Attachment A;

through equal rate reductions of customs duties beginning in 1997 and concluding in 2000, recognizing that extended staging of reductions and, before implementation, expansion of product coverage may be necessary in limited circumstances.

3. Ministers express satisfaction about the large product coverage outlined in the Attachments to the Annex to this Declaration. They instruct their respective officials to make good faith efforts to finalize plurilateral technical discussions in Geneva on the basis of these modalities, and instruct these officials to complete this work by 31 January 1997, so as to ensure the implementation of this Declaration by the largest number of participants.

4. Ministers invite the Ministers of other Members of the WTO, and States or separate customs territories in the process of acceding to the WTO, to provide similar instructions to their respective officials, so that they may participate in the technical discussions referred to in paragraph 3 above and participate fully in the expansion of world trade in information technology products.

Annex: Modalities and Product Coverage

Attachment A: list of HS headings

Attachment B: list of products

## ANNEX

Modalities and Product Coverage

Any Member of the World Trade Organization, or State or separate customs territory in the process of acceding to the WTO, may participate in the expansion of world trade in information technology products in accordance with the following modalities:

1. Each participant shall incorporate the measures described in paragraph 2 of the Declaration into its schedule to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, and, in addition, at either its own tariff line level or the Harmonized System (1996) ("HS") 6-digit level in either its official tariff or any other published versions of the tariff schedule, whichever is ordinarily used by importers and exporters. Each participant that is not a Member of the WTO shall implement these measures on an autonomous basis, pending completion of its WTO accession, and shall incorporate these measures into its WTO market access schedule for goods.

2. To this end, as early as possible and no later than 1 March 1997 each participant shall provide all other participants a document containing (a) the details concerning how the appropriate duty treatment will be provided in its WTO schedule of concessions, and (b) a list of the detailed HS headings involved for products specified in Attachment B. These documents will be reviewed and approved on a consensus basis and this review process shall be completed no later than 1 April 1997. As soon as this review process has been completed for any such document, that document shall be submitted as a modification to the Schedule of the participant concerned, in accordance with the Decision of 26 March 1980 on Procedures for Modification and Rectification of Schedules of Tariff Concessions (BISD 27S/25).

- (a) The concessions to be proposed by each participant as modifications to its Schedule shall bind and eliminate all customs duties and other duties and charges of any kind on information technology products as follows:
  - (i) elimination of such customs duties shall take place through rate reductions in equal steps, except as may be otherwise agreed by the participants. Unless otherwise agreed by the participants, each participant shall bind all tariffs on items listed in the Attachments no later than 1 July 1997, and shall make the first such rate reduction effective no later than 1 July 1997, the second such rate reduction no later than 1 January 1998, and the third such rate reduction no later than 1 January 1999, and the elimination of customs duties shall be completed effective no later than 1 January 2000. The participants agree to encourage autonomous elimination of customs duties prior to these dates. The reduced rate should in each stage be rounded off to the first decimal; and
  - (ii) elimination of such other duties and charges of any kind, within the meaning of Article II:1(b) of the General Agreement, shall be completed by 1 July 1997, except as may be otherwise specified in the participant's document provided to other participants for review.
- (b) The modifications to its Schedule to be proposed by a participant in order to implement its binding and elimination of customs duties on information technology products shall achieve this result:
  - (i) in the case of the HS headings listed in Attachment A, by creating, where appropriate, sub-divisions in its Schedule at the national tariff line level; and

- (ii) in the case of the products specified in Attachment B, by attaching an annex to its Schedule including all products in Attachment B, which is to specify the detailed HS headings for those products at either the national tariff line level or the HS 6-digit level.

Each participant shall promptly modify its national tariff schedule to reflect the modifications it has proposed, as soon as they have entered into effect.

3. Participants shall meet periodically under the auspices of the Council on Trade in Goods to review the product coverage specified in the Attachments, with a view to agreeing, by consensus, whether in the light of technological developments, experience in applying the tariff concessions, or changes to the HS nomenclature, the Attachments should be modified to incorporate additional products, and to consult on non-tariff barriers to trade in information technology products. Such consultations shall be without prejudice to rights and obligations under the WTO Agreement.

4. Participants shall meet as soon as practicable and in any case no later than 1 April 1997 to review the state of acceptances received and to assess the conclusions to be drawn therefrom. Participants will implement the actions foreseen in the Declaration provided that participants representing approximately 90 per cent of world trade<sup>2</sup> in information technology products have by then notified their acceptance, and provided that the staging has been agreed to the participants' satisfaction. In assessing whether to implement actions foreseen in the Declaration, if the percentage of world trade represented by participants falls somewhat short of 90 per cent of world trade in information technology products, participants may take into account the extent of the participation of States or separate customs territories representing for them the substantial bulk of their own trade in such products. At this meeting the participants will establish whether these criteria have been met.

5. Participants shall meet as often as necessary and no later than 30 September 1997 to consider any divergence among them in classifying information technology products, beginning with the products specified in Attachment B. Participants agree on the common objective of achieving, where appropriate, a common classification for these products within existing HS nomenclature, giving consideration to interpretations and rulings of the Customs Co-operation Council (also known as the World Customs Organization or "WCO"). In any instance in which a divergence in classification remains, participants will consider whether a joint suggestion could be made to the WCO with regard to updating existing HS nomenclature or resolving divergence in interpretation of the HS nomenclature.

6. The participants understand that Article XXIII of the General Agreement will address nullification or impairment of benefits accruing directly or indirectly to a WTO Member participant through the implementation of this Declaration as a result of the application by another WTO Member participant of any measure, whether or not that measure conflicts with the provisions of the General Agreement.

7. Each participant shall afford sympathetic consideration to any request for consultation from any other participant concerning the undertakings set out above. Such consultations shall be without prejudice to rights and obligations under the WTO Agreement.

8. Participants acting under the auspices of the Council for Trade in Goods shall inform other Members of the WTO and States or separate customs territories in the process of acceding to the WTO of these modalities and initiate consultations with a view to facilitate their participation in the expansion of trade in information technology products on the basis of the Declaration.

---

<sup>2</sup>This percentage shall be calculated by the WTO Secretariat on the basis of the most recent data available at the time of the meeting.



9. As used in these modalities, the term "participant" shall mean those Members of the WTO, or States or separate customs territories in the process of acceding to the WTO, that provide the document described in paragraph 2 no later than 1 March 1997.

10. This Annex shall be open for acceptance by all Members of the WTO and any State or any separate customs territory in the process of acceding to the WTO. Acceptances shall be notified in writing to the Director-General who shall communicate them to all participants.

There are two attachments to the Annex.

Attachment A lists the HS headings or parts thereof to be covered.

Attachment B lists specific products to be covered by an ITA wherever they are classified in the HS .

## Attachment A, Section 1

	HS96		HS description
	3818		Chemical elements doped for use in electronics, in form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics
	8469	11	Word processing machines
	8470		Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with a calculating function; accounting machines, postage franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating devices; cash registers:
	8470	10	Electronic calculators capable of operating without an external source of electric power and pocket size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions
	8470	21	Other electronic calculating machines incorporating a printing device
	8470	29	Other
	8470	30	Other calculating machines
	8470	40	Accounting machines
	8470	50	Cash registers
	8470	90	Other
	8471		Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included:
	8471	10	Analogue or hybrid automatic data processing machines
	8471	30	Portable digital automatic data processing machines, weighing no more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display
	8471	41	Other digital automatic data processing machines comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and output unit, whether or not combined
	8471	49	Other digital automatic data processing machines presented in the form of systems
	8471	50	Digital processing units other than those of subheading 8471 41 and 8471 49, whether or not in the same housing one or two of the following types of units : storage units, input units, output units
	8471	60	Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing
	8471	70	Storage units, including central storage units, optical disk storage units, hard disk drives and magnetic tape storage units
	8471	80	Other units of automatic data processing machines
	8471	90	Other
ex	8472	90	Automatic teller machines
	8473	21	Parts and accessories of the machines of heading No 8470 of the electronic calculating machines of subheading 8470 10, 8470 21 and 8470 29
	8473	29	Parts and accessories of the machines of heading No 8470 other than the electronic calculating machines of subheading 8470 10, 8470 21 and 8470 29
	8473	30	Parts and accessories of the machines of heading No 8471

	8473	50	Parts and accessories equally suitable for use with machines of two or more of the headings Nos. 8469 to 8472
ex	8504	40	Static converters for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus
ex	8504	50	Other inductors for power supplies for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication apparatus
	8517		Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including line telephone sets with cordless handsets and telecommunication apparatus for carrier-current line systems or for digital line systems; videophones:
	8517	11	Line telephone sets with cordless handsets
	8517	19	Other telephone sets and videophones
	8517	21	Facsimile machines
	8517	22	Teleprinters
	8517	30	Telephonic or telegraphic switching apparatus
	8517	50	Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line systems
	8517	80	Other apparatus including entry-phone systems
	8517	90	Parts of apparatus of heading 8517
ex	8518	10	Microphones having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter of not exceeding 10 mm and a height not exceeding 3 mm, for telecommunication use
ex	8518	30	Line telephone handsets
ex	8518	29	Loudspeakers, without housing, having a frequency range of 300 Hz to 3,4 KHz with a diameter of not exceeding 50 mm, for telecommunication use
	8520	20	Telephone answering machines
	8523	11	Magnetic tapes of a width not exceeding 4 mm
	8523	12	Magnetic tapes of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6,5 mm
	8523	13	Magnetic tapes of a width exceeding 6,5 mm
	8523	20	Magnetic discs
	8523	90	Other
	8524	31	Discs for laser reading systems for reproducing phenomena other than sound or image
ex	8524	39	Other : - for reproducing representations of instructions, data, sound, and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine
	8524	40	Magnetic tapes for reproducing phenomena other than sound or image
	8524	91	Media for reproducing phenomena other than sound or image
ex	8424	99	Other : - for reproducing representations of instructions, data, sound, and image, recorded in a machine readable binary form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine
ex	8525	10	Transmission apparatus other than apparatus for radio-broadcasting or television
	8525	20	Transmission apparatus incorporating reception apparatus
ex	8525	40	Digital still image video cameras
ex	8527	90	Portable receivers for calling, alerting or paging
ex	8529	10	Aerials or antennae of a kind used with apparatus for radio-telephony and radio-telegraphy

ex	8529	90	Parts of: transmission apparatus other than apparatus for radio-broadcasting or television transmission apparatus incorporating reception apparatus digital still image video cameras, portable receivers for calling, alerting or paging
	8531	20	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes (LED)
ex	8531	90	Parts of apparatus of subheading 8531 20
	8532		Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set):
	8532	10	Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive power handling capacity of not less than 0,5 kvar (power capacitors)
	8532	21	Tantalum fixed capacitors
	8532	22	Aluminium electrolytic fixed capacitors
	8532	23	Ceramic dielectric, single layer fixed capacitors
	8532	24	Ceramic dielectric, multilayer fixed capacitors
	8532	25	Dielectric fixed capacitors of paper or plastics
	8532	29	Other fixed capacitors
	8532	30	Variable or adjustable (pre-set) capacitors
	8532	90	Parts
	8533		Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors:
	8533	10	Fixed carbon resistors, composition or film types
	8533	21	Other fixed resistors for a power handling capacity not exceeding 20 W
	8533	29	Other fixed resistors for a power handling capacity of 20 W or more
	8533	31	Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers, for a power handling capacity not exceeding 20 W
	8533	39	Wirewound variable resistors, including rheostats and potentiometers, for a power handling capacity of 20 W or more
	8533	40	Other variable resistors, including rheostats and potentiometers
	8533	90	Parts
	8534		Printed circuits
ex	8536	50	Electronic AC switches consisting of optically coupled input and output circuits (Insulated thyristor AC switches)
ex	8536	50	Electronic switches, including temperature protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip (chip-on-chip technology) for a voltage not exceeding 1000 volts
ex	8536	50	Electromechanical snap-action switches for a current not exceeding 11 amps
ex	8536	69	Plugs and sockets for co-axial cables and printed circuits
ex	8536	90	Connection and contact elements for wires and cables
	8541		Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes; mounted piezo-electric crystals:
	8541	10	Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes
	8541	21	Transistors, other than photosensitive transistors, with a dissipation rate of less than 1 W
	8541	29	Transistors, other than photosensitive transistors, with a dissipation rate of 1 W or more

	8541	30	Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices
	8541	40	Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes
	8541	50	Other semiconductor devices
	8541	60	Mounted piezo-electric crystals
	8541	90	Parts
	<b>8542</b>		<b>Electronic integrated circuits and microassemblies</b>
	8542	12	Cards incorporating an electronic integrated circuit ('smart' cards)
	8542	13	Metal oxide semiconductors (MOS technology)
	8542	14	Circuits obtained by bipolar technology
	8542	19	Other monolithic digital integrated circuits, including circuits obtained by a combination of bipolar and MOS technologies (BIMOS technology)
	8542	30	Other monolithic integrated circuits
	8542	40	Hybrid integrated circuits
	8542	50	Electronic microassemblies
	8542	90	Part
	<b>8543</b>	<b>81</b>	<b>Proximity cards and tags</b>
ex	8543	89	Electrical machines with translation or dictionary functions
ex	8544	41	Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V, fitted with connectors, of a kind used for telecommunications
ex	8544	49	Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80 V, not fitted with connectors, of a kind used for telecommunications
ex	8544	51	Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 V but not exceeding 1000 V, fitted with connectors, of a kind used for telecommunications
	8544	70	Optical fibre cables
	9009	11	Electrostatic photocopying apparatus, operating by reproducing the original image directly onto the copy (direct process)]
	9009	21	Other photocopying apparatus, incorporating an optical system
	9009	90	Parts and accessories
	9026		Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading No 9014, 9015, 9028 or 9032:
	9026	10	Instruments for measuring or checking the flow or level of liquids
	9026	20	Instruments and apparatus for measuring or checking pressure
	9026	80	Other instruments and apparatus for measuring or checking of heading 9026
	9026	90	Parts and accessories of instruments and apparatus of heading 9026
	9027	20	Chromatographs and electrophoresis instruments
	9027	30	Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR)
	9027	50	Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR) of heading No 9027
	9027	80	Other instruments and apparatus of heading No 9027 (other than those of heading No 9027 10)
ex	9027	90	Parts and accessories of products of heading 9027, other than for gas or smoke analysis apparatus and microtomes

	9030	40	Instruments and apparatus for measuring and checking, specially designed for telecommunications (for example, cross-talk meters, gain measuring instruments, distortion factor meters, psophometers)
--	------	----	--

## Attachment A, Section 2

Semiconductor manufacturing and testing equipment and parts thereof

	HS Code	Description	Comments
ex	7017 10	Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8419 89	Chemical vapor deposition apparatus for semiconductor production	For Attachment B
ex	8419 90	Parts of chemical vapor deposition apparatus for semiconductor production	For Attachment B
ex	8421 19	Spin dryers for semiconductor wafer processing	
ex	8421 91	Parts of spin dryers for semiconductor wafer processing	
ex	8424 89	Deflash machines for cleaning and removing contaminants from the metal leads of semiconductor packages prior to the electroplating process	
ex	8424 89	Spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers	
ex	8424 90	Parts of spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers	
ex	8456 10	Machines for working any material by removal of material, by laser or other light or photo beam in the production of semiconductor wafers	
ex	8456 91	Apparatus for stripping or cleaning semiconductor wafers	For Attachment B
	8456 91	Machines for dry-etching patterns on semiconductor materials	
ex	8456 99	Focused ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for patterns on semiconductor devices	
ex	8456 99	Lasercutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam	For Attachment B
ex	8464 10	Machines for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips	For Attachment B
ex	8464 20	Grinding, polishing and lapping machines for processing of semiconductor wafers	
ex	8464 90	Dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers	
ex	8466 91	Parts for machines for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips	For Attachment B
ex	8466 91	Parts of dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8466 91	Parts of grinding, polishing and lapping machines for processing of semiconductor wafers	
ex	8466 93	Parts of focused ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for patterns on semiconductor devices	
ex	8466 93	Parts of lasercutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam	For Attachment B
ex	8466 93	Parts of machines for working any material by removal of material, by laser or other light or photo beam in the production of semiconductor wafers	
ex	8466 93	Parts of apparatus for stripping or cleaning semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8466 93	Parts of machines for dry-etching patterns on semiconductor materials	
ex	8477 10	Encapsulation equipment for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8477 90	Parts of encapsulation equipment	For Attachment B

ex	8479 50	Automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices	For Attachment B
ex	8479 89	Apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules	
ex	8479 89	Apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8479 89	Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays	For Attachment B
ex	8479 89	Die attach apparatus, tape automated bonders, and wire bonders for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8479 89	Encapsulation equipment for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8479 89	Epitaxial deposition machines for semiconductor wafers	
ex	8479 89	Machines for bending, folding and straightening semiconductor leads	For Attachment B
ex	8479 89	Physical deposition apparatus for for semiconductor production	For Attachment B
ex	8479 89	Spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8479 90	Part of apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8479 90	Parts for die attach apparatus, tape automated bonders, and wire bonders for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8479 90	Parts for spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules	
ex	8479 90	Parts of apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of encapsulation equipment for assembly of semiconductors	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of epitaxial deposition machines for semiconductor wafers	
ex	8479 90	Parts of machines for bending, folding and straightening semiconductor leads	For Attachment B
ex	8479 90	Parts of physical deposition apparatus for for semiconductor production	For Attachment B
ex	8480 71	Injection and compression moulds for the manufacture of semiconductor devices	
ex	8514 10	Resistance heated furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	
ex	8514 20	Inductance or dielectric furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	
ex	8514 30	Apparatus for rapid heating of semiconductor wafers	For Attachment B
ex	8514 30	Parts of resistance heated furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers	
ex	8514 90	Parts of apparatus for rapid heating of wafers	For Attachment B
ex	8514 90	Parts of furnaces and ovens of Headings No 8514 10 to No 8514 30	
ex	8536 90	Wafer probers	For Attachment B
	8543 11	Ion implanters for doping semiconductor materials	
ex	8543 30	Apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays	For Attachment B



ex	8543 90	Parts of apparatus for wet etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays	For Attachment B
ex	8543 90	Parts of ion implanters for doping semiconductor materials	
	9010 41 to 9010 49	Apparatus for projection, drawing or plating circuit patterns on sensitized semiconductor materials and flat panel displays	
ex	9010 90	Parts and accessories of the apparatus of Headings No 9010 41 to 9010 49	
ex	9011 10	Optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9011 20	Photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9011 90	Parts and accessories of optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9011 90	Parts and accessories of photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9012 10	Electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9012 90	Parts and accessories of electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles	For Attachment B
ex	9017 20	Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates	For Attachment B
ex	9017 90	Parts and accessories for pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates	For Attachment B
ex	9017 90	Parts of such pattern generating apparatus	For Attachment B
	9030 82	Instruments and apparatus for measuring or checking semiconductor wafers or devices	
ex	9030 90	Parts and accessories of instruments and apparatus for measuring or checking semiconductor wafers or devices	
ex	9030 90	Parts of instruments and appliances for measuring or checking semiconductor wafers or devices	
	9031 41	Optical instruments and appliances for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting masks, photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices	
ex	9031 49	Optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers	
ex	9031 90	Parts and accessories of optical instruments and appliances for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting masks, photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices	
ex	9031 90	Parts and accessories of optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers	

### Attachment B

Positive list of specific products to be covered by this agreement wherever they are classified in the HS.

Where parts are specified, they are to be covered in accordance with HS Notes 2(b) to Section XVI and Chapter 90, respectively.

<p><b>Computers:</b> automatic data processing machines capable of 1) storing the processing program or programs and at least the data immediately necessary for the execution of the program; 2) being freely programmed in accordance with the requirements of the user; 3) performing arithmetical computations specified by the user; and 4) executing, without human intervention, a processing program which requires them to modify their execution, by logical decision during the processing run.</p> <p>The agreement covers such automatic data processing machines whether or not they are able to receive and process with the assistance of central processing unit telephony signals, television signals, or other analogue or digitally processed audio or video signals. Machines performing a specific function other than data processing, or incorporating or working in conjunction with an automatic data processing machine, and not otherwise specified under Attachment A or B, are not covered by this agreement.</p>
<p><b>Electric amplifiers</b> when used as repeaters in line telephony products falling within this agreement, and parts thereof</p>
<p><b>Flat panel displays</b> (including LCD, Electro Luminescence, Plasma and other technologies) for products falling within this agreement, and parts thereof.</p>
<p><b>Network equipment:</b> Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN) apparatus, including those products dedicated for use solely or principally to permit the interconnection of automatic data processing machines and units thereof for a network that is used primarily for the sharing of resources such as central processor units, data storage devices and input or output units - including adapters, hubs, in-line repeaters, converters, concentrators, bridges and routers, and printed circuit assemblies for physical incorporation into automatic data processing machines and units thereof.</p>
<p><b>Monitors :</b> display units of automatic data processing machines with a cathode ray tube with a dot screen pitch smaller than 0,4 mm not capable of receiving and processing television signals or other analogue or digitally processed audio or video signals without assistance of a central processing unit of a computer as defined in this agreement.</p> <p>The agreement does not, therefore, cover televisions, including high definition televisions.<sup>3</sup></p>
<p><b>Optical disc storage units,</b> for automatic data processing machines (including CD drives and DVD-drives), whether or not having the capability of writing/recording as well as reading, whether or not in their own housings.</p>
<p><b>Paging alert devices,</b> and parts thereof .</p>
<p><b>Plotters</b> whether input or output units of HS heading No 8471 or drawing or drafting machines of HS heading No 9017.</p>
<p><b>Printed Circuit Assemblies</b> for products falling within this agreement, including such assemblies for external connections such as cards that conform to the PCMCIA standard.</p> <p>Such printed circuit assemblies consist of one or more printed circuits of heading 8534 with one or more active elements assembled thereon, with or without passive elements "Active elements" means diodes, transistors, and similar semiconductor devices, whether or not photosensitive, of heading 8541, and integrated circuits and micro assemblies of heading 8542.</p>
<p><b>Projection type flat panel display units</b> used with automatic data processing machines which can display digital information generated by the central processing unit.</p>

<sup>3</sup> Participants will conduct a review of this product description in January 1999 under the consultation provisions of paragraph 3 of the Declaration

**Proprietary format storage devices** including media therefor for automatic data processing machines, with or without removable media and whether magnetic, optical or other technology, including Bernoulli Box, Syquest, or Zipdrive cartridge storage units.

**Multimedia upgrade kits** for automatic data processing machines, and units thereof, put up for retail sale, consisting of, at least, speakers and/or microphones as well as a printed circuit assembly that enables the ADP machines and units thereof to process audio signals (sound cards).

**Set top boxes which have a communication function:** a microprocessor-based device incorporating a modem for gaining access to the Internet, and having a function of interactive information exchange

- Po zapoznaniu się z powyższą Deklaracją Ministerialną, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
  - jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
  - będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 grudnia 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Kwaśniewski*  
L.S.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*